



平成 29 年 5 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信〔日 本 基 準〕(非 連 結)

平成 28 年 9 月 30 日

上 場 会 社 名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp/>
 代 表 者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 中澤 正幸
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部担当 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011
 四半期報告書提出予定日 平成 28 年 10 月 14 日 配当支払開始予定日 ー
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成 29 年 5 月 期 第 1 四 半 期 の 業 績 (平成 28 年 6 月 1 日 ~ 平成 28 年 8 月 31 日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29 年 5 月 期 第 1 四 半 期	16,003	11.6	1,067	1.6	981	△2.6	662	△1.9
28 年 5 月 期 第 1 四 半 期	14,343	29.9	1,050	44.2	1,006	30.4	675	34.8

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
29 年 5 月 期 第 1 四 半 期	20.61	—
28 年 5 月 期 第 1 四 半 期	20.17	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29 年 5 月 期 第 1 四 半 期	75,122	54,216	72.2
28 年 5 月 期	76,775	53,923	70.2

(参考)自己資本 29 年 5 月 期 第 1 四 半 期 54,216 百万円 28 年 5 月 期 53,923 百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期 末	合 計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28 年 5 月 期	—	13.00	—	13.00	26.00
29 年 5 月 期	—	—	—	—	—
29 年 5 月 期 (予想)	—	13.00	—	13.00	26.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成 29 年 5 月 期 の 業 績 予 想 (平成 28 年 6 月 1 日 ~ 平成 29 年 5 月 31 日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	28,500	1.8	2,050	2.4	1,950	△1.3	1,300	△2.9	40.46
通 期	57,000	1.2	3,500	0.6	3,400	2.8	2,250	2.0	70.03

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は【添付資料】3ページ「(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

29年5月期1Q	35,497,183株	28年5月期	35,497,183株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

29年5月期1Q	3,368,398株	28年5月期	3,368,350株
----------	------------	--------	------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

29年5月期1Q	32,128,785株	28年5月期1Q	33,480,633株
----------	-------------	----------	-------------

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期財務諸表	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	6
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が底堅く推移するなど、全体として緩やかな回復基調が継続いたしました。

半導体業界におきましては、メモリデバイスの需要は堅調に推移し、ロジックデバイスの需要も回復基調にあることから、シリコンウエハーの生産は高水準で推移いたしました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第1四半期累計期間の売上高は160億3百万円と前年同四半期比11.6%の増収となり、営業利益は10億6千7百万円（前年同四半期比1.6%増）、経常利益は9億8千1百万円（同2.6%減）、四半期純利益は6億6千2百万円（同1.9%減）となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、主力の300mmウエハーを中心として、生産は高水準で推移いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、その他の取扱商品において増収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期会計期間末における総資産は、商品及び製品の減少等により、前事業年度末と比較して16億5千2百万円減少し、751億2千2百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により19億4千6百万円減少し、209億5百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加2億9千3百万円等により、542億1千6百万円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成28年7月15日の「平成28年5月期 決算短信」で公表いたしました第2四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。)を当第1四半期会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加算しております。

これによる四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。

3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成28年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,224	21,728
受取手形及び売掛金	21,376	22,158
商品及び製品	2,339	385
仕掛品	455	263
原材料及び貯蔵品	1,822	1,843
その他	1,294	1,652
貸倒引当金	△3	△4
流動資産合計	49,509	48,028
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	11,282	11,102
その他(純額)	13,124	13,138
有形固定資産合計	24,407	24,240
無形固定資産	548	526
投資その他の資産		
その他	2,315	2,334
貸倒引当金	△6	△6
投資その他の資産合計	2,309	2,328
固定資産合計	27,265	27,094
資産合計	76,775	75,122
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	15,770	14,618
短期借入金	100	100
未払法人税等	263	167
引当金	60	409
その他	3,881	2,624
流動負債合計	20,076	17,919
固定負債		
長期借入金	400	375
退職給付引当金	1,743	1,721
その他	632	889
固定負債合計	2,776	2,985
負債合計	22,852	20,905

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成28年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成28年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	21,029	21,323
自己株式	△4,762	△4,762
株主資本合計	53,869	54,162
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	53	53
評価・換算差額等合計	53	53
純資産合計	53,923	54,216
負債純資産合計	76,775	75,122

(2) 四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期累計期間 (自平成27年6月1日 至平成27年8月31日)	当第1四半期累計期間 (自平成28年6月1日 至平成28年8月31日)
売上高	14,343	16,003
売上原価	12,611	14,305
売上総利益	1,732	1,698
販売費及び一般管理費	681	630
営業利益	1,050	1,067
営業外収益		
受取利息	2	1
受取配当金	4	4
その他	10	6
営業外収益合計	17	12
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	59	98
その他	1	0
営業外費用合計	61	98
経常利益	1,006	981
特別利益		
固定資産売却益	0	1
特別利益合計	0	1
特別損失		
固定資産除却損	5	8
その他	26	28
特別損失合計	32	36
税引前四半期純利益	974	945
法人税、住民税及び事業税	157	101
法人税等調整額	142	181
法人税等合計	299	283
四半期純利益	675	662

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報
前第1四半期累計期間(自 平成27年6月1日 至 平成27年8月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	5,997	8,345	—	14,343	—	14,343
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	—	915	917	△917	—
合計	5,999	8,345	915	15,260	△917	14,343

当第1四半期累計期間(自 平成28年6月1日 至 平成28年8月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	6,017	9,985	—	16,003	—	16,003
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	—	545	545	△545	—
合計	6,018	9,985	545	16,549	△545	16,003